

TIF™100LN-1535-06 系列导热垫能填充发热器件和散热片或金属底座二者之间空气间隙。它们的柔性、弹性特征使其能够用于非常不平整的表面，其优异的效能使热量从发热器件或整个PCB传导金属外壳或扩散板上，从而提高发热电子组件的效率和使用寿命。

TIF™100LN-1535-06 系列特性表

颜色	白色	Visual
结构&成份	陶瓷填充硅橡胶	*****
厚度范围	0.01"(0.25mm)~0.20" (5.0mm)	ASTM D374
硬度 (Shore00)	35°	ASTM 2240
比重g/cc	1.24	ASTM D297
使用温度范围	-40~160°C	*****
击穿电压(T= 1.0mm )	>5500 VAC	ASTM D149
介电常数 (MHz)	2.5	ASTM D150
表面电阻率	> 1.0X10 <sup>12</sup> Ohm-cm	ASTM D257
热传导率	1.5W/mK	ASTM D5470
	1.5 W/mK	ISO22007-2.2

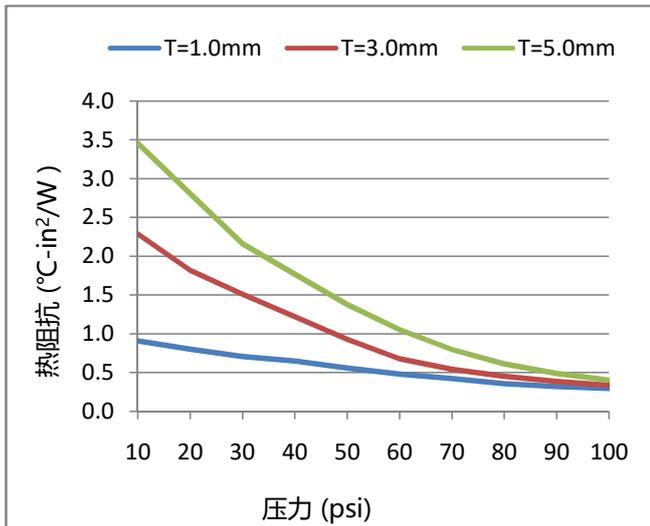
**特性**

- 》良好的热传导率
- 》带自粘而无需额外表面粘合剂
- 》高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于低压力应用环境
- 》可提供多种厚度选择

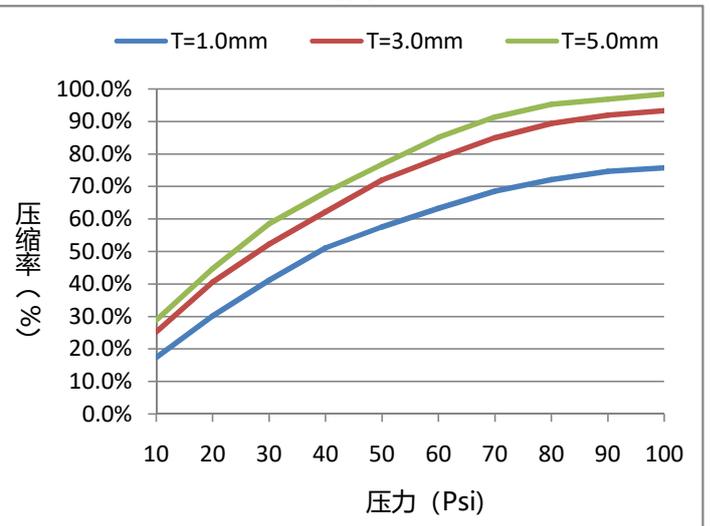
**应用**

- 》散热器底部或框架
- 》机顶盒
- 》电源与车用蓄电池
- 》充电桩
- 》LED电视、灯具
- 》显卡模组

**热阻抗**



**压缩率**



**产品规格**

标准厚度:0.010"(0.25mm)~0.200" (5.0mm)      标准尺寸:8"×16" (203mm×406mm)  
 TIF系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度请与本公司联系。欲了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系。

导热材料

发热材料

导热工程塑料

发泡硅胶

模切制品

加拿大 Canada  
 TEL: +001-604-2998559  
 E-mail: frances@ziitek.com.tw  
<http://www.thermazig.com>

台湾 Taiwan  
 TEL: +886-2-22771007  
 E-mail: frances@ziitek.com.tw  
<http://www.ziitek.com.tw>

东莞 Dongguan  
 TEL: +86-769-38801208  
 E-mail: frances@ziitek.com.tw  
<http://www.ziitek.com.cn>

昆山 Kunshan  
 TEL: +86-512-57816297  
 E-mail: kelvin@ziitek.com  
<http://www.ziitek.com.cn>

杭州 Hangzhou  
 TEL: +86-571-63850366  
 E-mail: alex@ziitek.com  
<http://www.ziitek.com.cn>

长沙 Changsha  
 TEL: +86-731-86949836  
 E-mail: jor@ziitek.com  
<http://www.ziitek.com.cn>